# 多孔 Sialon 陶瓷的冷冻凝胶法制备与表征

### 王涛 余娟丽 吕毅 郭世峰 裴雨辰

(航天特种材料及工艺技术研究所,北京 100074)

**文 摘** 采用冷冻凝胶成型和无压烧结工艺制备了多孔 Sialon 陶瓷材料,通过 X 射线衍射分析了材料的 晶相组成,观察了材料的显微结构形貌,测试了材料的弯曲强度和介电常数。结果表明:z 值影响材料的晶相 组成,浆料的固相体积分数影响材料的性能,当 z=2.5,固相体积分数为 60% 时,材料的弯曲强度达到 116 MPa,介电常数为 4.79。

关键词 冷冻成型, Sialon, XRD, SEM 中图分类号: TO127.2

DOI:10.3969/j.issn.1007-2330.2015.04.010

## Fabrication and Characterization of Porous Sialon Ceramics by Freeze Casting Technique

WANG Tao YU Juanli LV Yi GUO Shifeng PEI Yuchen (Research Institute of Aerospace Special Materials and Processing Technology, Beijing 100074)

**Abstract** Porous sialon ceramics was fabricated by freeze casting technique and pressureless sitering process. Crystalline phases of the as-sintered specimens were identified by X-ray diffraction (XRD). Microstructures were examined by scanning electron microscopy (SEM). Mechanical and dielectric properties of the material were investigated. The crystalline phases and properties are influenced by *z* value in initial compositions and solids loading of the slurries. The flexural strength and dielectric constant reach 116 MPa and 4.79, respectively, with z = 2.5 and solid loading of 60vol%.

Key words Freeze Casting, Sialon, XRD, SEM

#### 0 引言

Sialon 陶瓷具有优异的力学、热学性能和化学稳定性,被认为是有望广泛应用的高温陶瓷材料之一<sup>[1-2]</sup>。目前,Sialon 陶瓷通常采用干压、冷等静压、热压等干法技术成型<sup>[3-8]</sup>,只能制备形状简单的材料件,复杂形状制品需要进行长时间的机械加工,增加了研制成本,同时,材料的均匀性也不易控制<sup>[9-10]</sup>,影响了其进一步推广应用。

本文采用冷冻凝胶成型工艺,以 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、AlN、SiO<sub>2</sub>、硅溶胶为起始原料,以 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为烧结助剂,制备Sialon 陶瓷,分析原料组成、固相体积含量对材料晶相、形貌、弯曲强度和介电常数的影响。

#### 1 实验

#### 1.1 原料

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 粉体(D50:0.5 μm, α 相含量≥94%, 纯度

大于 99.2%), AlN 粉体(D50:0.8 μm, 纯度> 98.6%), SiO<sub>2</sub> 粉体(D50:5 μm, 非晶态, 纯度>99. 8%), 硅溶胶(固含量 23vol%, pH=8.3), Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉体 (D50:2 μm, 纯度>99.9%)。

#### 1.2 仪器设备

QM-2SP20-CL 球磨机,南京大学仪器厂;ZT-150-20 烧结设备,上海晨华电炉厂;Rigaku D/max-2500X 射线衍射仪(XRD),日本理学公司;Quanta 200 FEG 扫描电镜(SEM),美国 FEI 公司;AG-2000A 型材料试验机,日本岛津公司;介电性能测试为非标 设备。

#### 1.3 实验过程

将 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、AlN、SiO<sub>2</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉体加入 500 mL 硅溶 胶中,球磨 4 h,滴加 10 mL 0.2wt% 的 PVA 水溶液, 继续球磨 1 h,浆料经真空除泡后注入铝制模具中密

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2015 年 第4 期

收稿日期:2015-04-20

作者简介:王涛,1983年出生,工程师,主要从事耐高温透波材料研究。E-mail:wt037@163.com

封,在液氮中静置 15 min 即可脱模,湿坯干燥 36 h 后,在氮气气氛下,以 4℃/min 的速率升温到 1

680℃,保温2h,自然降温。材料试样的设计组成如 表1 所示。

表1 材料的设计组成

 Tab. 1
 Initial composition of materials

试样	${\rm Si_3N_4/g}$	AlN/g	${\rm SiO_2/g}$	$Y_2O_3/g$	硅溶胶/mL	去离子水/mL	<i>z</i> 值	固含量/vol%
 Z20S45	440.00	243.00	0	45.40	350	100	2	45
Z25845	325.00	300.00	42.60	44.50	350	100	2.5	45
Z30S45	156.00	258.00	12.40	31.80	350	0	3	45
Z35S45	77.00	297.00	40.80	31.20	350	0	3.5	45
Z40S45	0	335.00	68.50	30.60	350	0	4	45
Z25S40	265.00	244.00	0	36.20	350	100	2.5	40
Z25S50	290.00	267.00	18.75	39.60	350	0	2.5	50
Z25855	354.00	326.00	62.30	48.40	350	0	2.5	55
Z25S60	435.00	401.00	116.70	59.40	350	0	2.5	60
Z25S63	494.00	455.00	156.40	67.50	350	0	2.5	63

#### 1.4 性能测试

XRD 测试参照 GB/T 30904—2014 进行;弯曲强度、弹性模量测试按照 GB/T 6569—2006 进行;介电常数、损耗角正切采用高Q 腔法在 10 GHz 下测试。

#### 2 结果与分析

— 44 —

#### 2.1 z 值对材料晶相组成的影响

以 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、AlN、SiO<sub>2</sub> 为原料制备 Sialon 陶瓷的反 应式为:

$$(4-z)$$
Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>+2zAlN+zSiO<sub>2</sub>  $\longrightarrow$  2Si<sub>6-z</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>N<sub>8-z</sub> (0

其中 z 值影响材料中各元素的比例,从而决定了 材料的晶相组成,不同 z 值对应材料试样的 XRD 图 谱如图 1 所示。



图1 不同z值试样的 XRD 图谱

Fig. 1 XRD patterns of samples with different z value

从图中可以看到,试样主要由  $\beta$ -Si<sub>4</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>N<sub>6</sub> 和 β-Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>3</sub>N<sub>5</sub> 两种晶相组成。当 z = 2.0 时,试样 Z20S45 中含有少量的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O,Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 是上述反应过 程的中间产物,该组分的存在表明反应并未完全,可 能与液相烧结助剂量不足有关;当z从 3.0 逐渐提高 到 4.0 时,试样中 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的衍射峰逐渐增强,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 是 AlN 水解引入的,随着z值的提高,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 的相对含量 降低,Al 和 O 原子不能充分进入 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 的晶格,在降 温过程中更容易析出的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;当z=2.5 时,图中只 发现了  $\beta$ -Si<sub>4</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>N<sub>6</sub> 和  $\beta$ -Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>3</sub>N<sub>5</sub> 的衍射峰,没 有其他杂质峰,表明试样中只含有 Sialon 相。

#### 2.2 固含量对材料密度和孔隙率的影响

表 2 是不同固含量的料浆所制备材料试样的照 片以及其密度和孔隙率。当浆料固含量为 40vol% 时,试样的密度为 1.84 g/cm<sup>3</sup>,孔隙率为 48.91%,这 是由于其固含量较低,冷冻过程中冰晶取向生长,在 坯体中形成了大量的微小裂纹,因此,较低的固含量 不利于坯体的冷冻成型。当浆料的固含量从 45vol% 提高到 60vol%时,材料的密度从 2.03 g/cm<sup>3</sup> 提高到 2.19 g/cm<sup>3</sup>,孔隙率从 43.16%下降到 39.16%,试样 表面平整均匀,无可见裂纹和缺陷。当浆料固含量进 一步提高时,其流动性变差,各组分在坯体中的分布 变差,导致试样在烧结过程中产生了大量的裂纹和缺 陷,当固含量提高到 63vol%时,试样的密度下降到 2.01 g/cm<sup>3</sup>,孔隙率提高到 44.07%。综上所述,浆料 的固含量控制在 45vol%~60vol%的范围以内,可以 制备出完整均匀的材料试样。

表 2 试样的密度和孔隙率

Tab. 2 Density and porosity of samples with different solid loading

试样	固含量/vol%	气孔率/%	密度/g·cm <sup>-3</sup>
Z25S40	40	48.91	1.84
Z25845	45	43.16	2.03
Z25850	50	41.12	2.12
Z25855	55	40.56	2.14
Z25860	60	39.16	2.19
Z25863	63	44.07	2.01

#### 2.3 固含量对材料显微结构形貌的影响

图 2 是试样的 SEM 照片,可以看到,试样中均生成了大量的长柱状晶粒,这些晶粒相互交错搭接,具 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2015 年 第 4 期 有和晶须类似的增强作用,可提高材料的强度;同时, 长柱状晶粒搭接形成了分布广泛的亚微米尺度孔隙, 有利于材料介电常数保持在较低的水平。此外,图 2

0xV 8 0mm 2045 St(1)

(a) Z25S40



(b) Z25S45

(f)中出现了明显的晶粒在局部聚集生长现象,这是由于浆料的固含量较高,流动性下降,烧结助剂分布 不均匀引起的。







(d) Z25855





(e) Z25S60图 2 不同固含量试样的 SEM 微观形貌

(f) Z25S63

Fig. 2 SEM photographs of samples with different solid loading

#### 2.4 固含量对材料力学性能的影响

从图 3 中可以看到,随着浆料的固含量从 40vol%提高到 60vol%,材料的弯曲强度和弹性模量 分别从 79.9 MPa 和 92.4 GPa 提高到了 115.9 MPa 和 96.5 GPa,当固含量不大于 60vol% 时,随浆料的固 含量提高,烧结后材料的致密度及其力学性能也随之 提高。当固含量超过 60vol% 后,浆料的均匀性下降, 烧结后材料的晶粒在局部聚集生长,导致试样表面和 内部出现较大的裂纹和缺陷,其弯曲强度和弹性模量 急剧下降。







#### 2.5 固含量对材料介电常数的影响

图 4 是试样介电性能随固含量的变化曲线。当 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2015 年 第 4 期 浆料的固含量为40vol%时,烧结后试样的介电常数 低于4.0;随着固含量提高,材料的密度提高,介电常 数也缓慢提高;当固含量达到60vol%时,试样的介电 常数接近4.8。材料的损耗角正切值变化不明显,始 终保持在0.006到0.008的较低水平。



图 4 介电常数随固含量的变化曲线



采用冷冻凝胶成型和无压烧结工艺制备的多孔 Sialon 陶瓷材料, XRD 分析表明,设计 z 值影响材料 的晶相组成,当 z=2.5 时,各组分充分转变为β-Sialon 陶瓷。浆料固相体积分数过高或过低时,烧结后 试样均会产生裂纹,材料性能下降;浆料的固含量在 45vol%~60vol%可得到显微结构良好的 Sialon 陶

— 45 —

瓷,材料的弯曲强度和介电常数随固含量的增加而提高,当固含量为 60vol% 时,材料的弯曲强度达到 115.9 MPa,介电常数为4.79。

#### 参考文献

[1] 姜涛,薛向欣,杨建. 复相 Sialon 陶瓷材料的研究进展[J]. 材料导报,2001,15(9):30-33

[2] Bandyopadhyay S, Petzow G. Formation of multiphase SiAlON ceramic[J]. Materials Chemistry and Physics, 1999, 61 (1): 9-13

[3] 高莉,张发廷,王浪峰. Sialon 粉体的无压烧结[J]. 材料导报,2013,27(z1):358-362

[4] 徐友仁,黄莉萍,符锡仁,等.添加稀土氧化物的热压 氮化硅陶瓷 [J]. 中国科学,1985,4A:384-387

 $[\,5\,]$  Ekstrom T. Reaction sintering of  $\beta\text{-sialon/Al}_2O_3/SiO_2$  mixtures in flowing nitrogen at high temperatures[J]. China's Refractories, 2005(1):41--34

[6] Hong Z L, Yoshida H, Ikuhara Y, et al. The effect of additives on sintering behavior and strength retention in silicon nitride with redisilicate[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2002, 22: 527–534

[7] Soraru G D, Ravagni A, Campostrini R, et al. Synthesis and characterization of  $\beta$ '-SiAlON ceramics from organo silicon polymers [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2001,74(9): 2220–2223

[8] 岳建设,王红洁,乔冠军.反应烧结制备多孔 β-SiAlON[J]. 硅酸盐学报,2012(4):489-492

[9] 桑绍柏,李亚伟,李楠. 长柱状 α-Sialon 形成机理及 其影响因素[J]. 材料导报,2004,18(10): 358-360

 $[\,10\,]$  Kishi K, Umbayashi S, Tani E. Influence of microstructure on strength and fracture toughness  $\beta\$ -sialon[J]. Journal of the Material Science, 2004, 25: 2780–2784

(编辑 吴坚)

(上接第42页)

可看出,风洞实验后,腻子未发生脱落、烧蚀、结构完整、致密。风洞实验过程中,腻子表面的长时间 温度为1200℃,最高温度为1400℃。风洞实验结果 说明:研制的腻子具有优异的高温稳定性和抗冲刷性 能。

#### 3 结论

HIT-J01 腻子对 C/SiC 室温粘接强度为 5.5 MPa,1 200℃粘接强度为 1.8 MPa,同时对 C/C 和气 凝胶材料具有良好的粘接性能。耐高温腻子涂层在 1 200℃热震循环 10 次后表面完整,这主要是制备的 耐高温腻子具有低膨胀的特性,同 C/SiC 热膨胀匹配 性良好,耐高温腻子在高温条件下生成的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、 (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>*n*</sub> 融体,吸收热冲击带来的内应力,从而提高 了耐高温腻子的抗热震性能。同时在粘接界面上出 现了细刺,铆钉结构。这种"钩键"、"锚键"结构提 高了腻子同 C/SiC 基材的高温粘接强度。在风洞实 验过程中,腻子的表面平均温度为 1 200℃,最高温度 1 400℃。风洞实验考核后耐高温腻子表面完整、致 密,表现了良好的抗冲刷性能。

#### 参考文献

[1] 杜善义. 高超声速飞行器的热防护材料及结构问题 [R]. 中国力学学术大会,2009

[2] 吴永志,李海刚,毛建英,等. C/SiC 与 TC4 钎焊接头的热震性能[J]. 宇航材料工艺,2012,42(5):64-68

[3] 陈泽明,徐鑫,王超,等. 碳基复合材料用耐高温胶 黏剂的研制[J]. 化学与黏合,2013(5):12-14+17

[4] Gladkikh S D, Mokrushin M G. Heat and high-temperature-resistant adhesives for joining carbon and ceramic materials[J]. Polymer Science, 2010,3(4):258-262

[5] 曾宪光,李新跃,杨巧凤. 一种改性硅酸盐胶粘涂层的制备[J]. 电镀与涂饰,2010,29(2):51-53

[6] 王晓红,刘俊能. 雷达吸波涂层胶粘剂的现状与发展[J]. 宇航材料工艺,1997(2):12-15+25

[7] 张建艺. 宇航应用的耐热胶粘剂[J]. 宇航材料工 艺,1990(4):89

[8] 孙举涛,黄玉东,曹海琳,等. 耐高温有机硅树脂的 合成及其耐热和固化性能研究[J]. 航空材料学报,2005(1): 25-29+35

#### (编辑 吴坚)

— 46 —